

戦略17分野等の人材育成に係る各種支援策の進捗状況（文部科学省）

資料 4

GRIT～成長分野等におけるリ・スキリングの戦略的推進～ (Growth-sector Reskilling and Innovative Training)

現状の取組

- ・戦略17分野等の業所管省庁にヒアリング（～2026.7）
- ・大学へのアプローチを実施（～2026.9）
- ・業所管省庁とともに企業や業界団体へのアプローチを実施（実施中）
- ・教育関係団体や都道府県へのアプローチを実施（実施中）

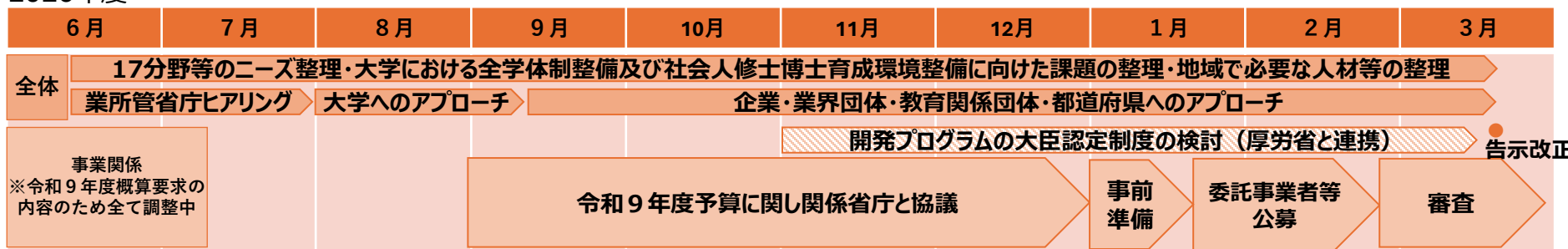
- 実需に応じたプログラム開発に向けた17分野等のニーズ整理
- 大学の全学的体制整備に向けた課題の整理
- 社会人修士・博士育成に向けた環境整備に係る課題の整理
- 地域で必要な人材と専門学校における人材育成の環境整備に係る課題の整理

今後の予定

（令和9年度概算要求の内容のため全て調整中）

- ・2027年度からの事業実施に向けた委託業者等選定（～2027.3）
- ・WG設置→人材像・スキル要件の整理（～2027.6）
- ・大学等・都道府県向け公募要領の整備、
大学等・都道府県の選定（～2027.7）
- ・大学等・都道府県における事業実施（2027.7～）
- ・プログラム開発、受講者募集（～2027.10）
- ・プログラム実施（2027.10～）

2026年度



2027年度



「GRIT」～成長分野等におけるリ・スキリングの戦略的推進～

(Growth-sector Reskilling and Innovative Training)

令和9年度要求・要望額

うち「強く豊かな日本」投資枠

702億円

702億円

(新規)



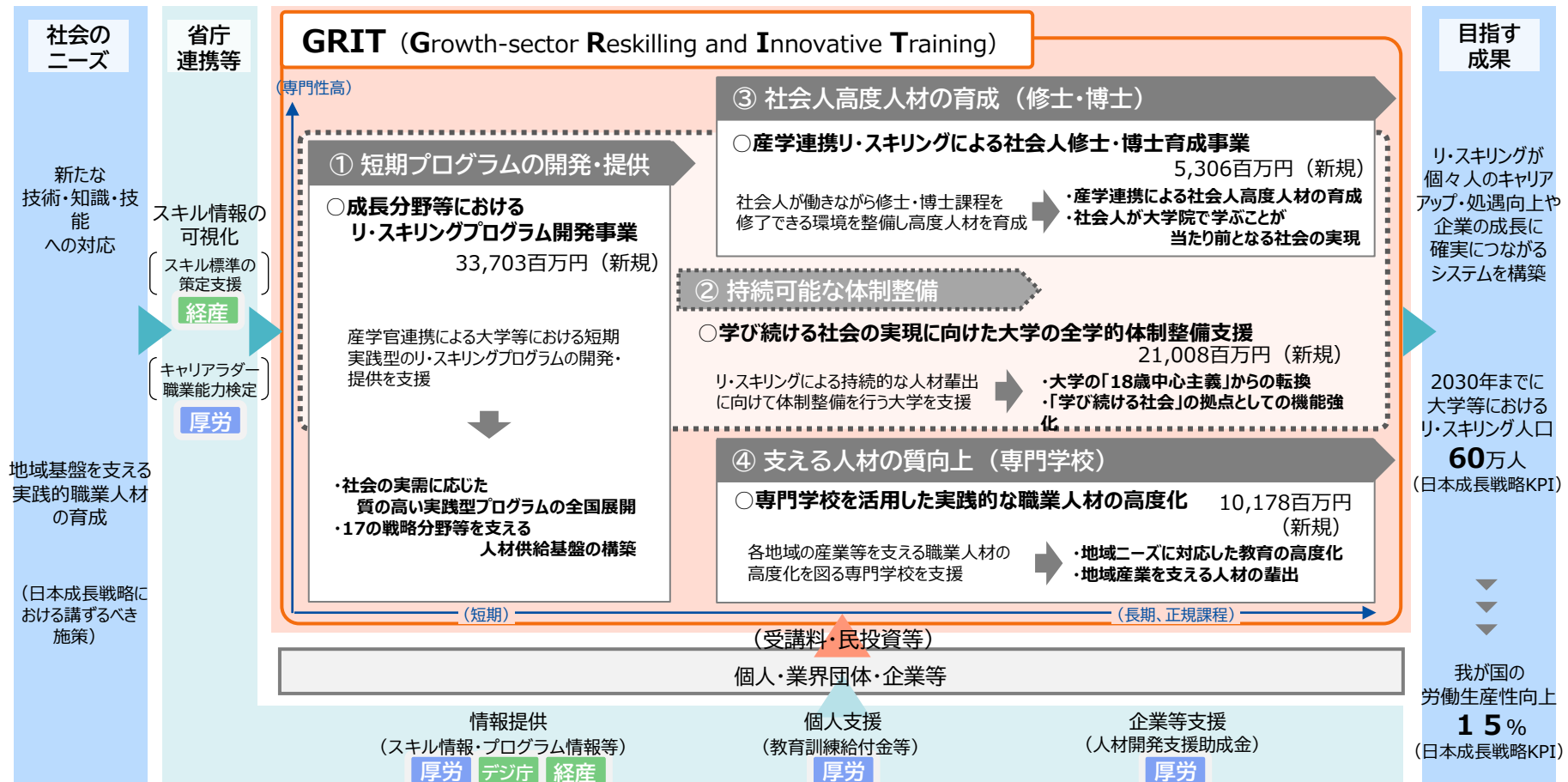
文部科学省

現状・課題

人口減少やA Xの進展、産業構造の変化に伴う人材需要の大きな変化が見込まれる中、将来の人材需要とのミスマッチを解消するため、17の戦略分野における課題を踏まえた人材や、それを支える人材を戦略的に育成することが求められている。また、地域ごとの人材需給ギャップの状況等も踏まえ、地域を支える必要な人材を確保していくことが必要。（「日本成長戦略2026」令和8年7月21日閣議決定）

事業内容

- ▶ 17の戦略分野を中心に、厚労省や経産省等と連携した一気通貫の支援により成長分野等の必要な人材育成を加速化
- ▶ 産学官連携による短期プログラムの開発・提供や全学的な体制整備等を支援することで、実践的専門人材の持続的供給基盤を構築



(担当：総合教育政策局生涯学習推進課)

企業ニーズを踏まえたリ・スキリングプログラムの例（AI・半導体）

学校法人 早稲田大学（AI）
スマートエスイー・エージェンティック・トランスフォーメーション

企業ニーズ（大手総合電機メーカー等）

- データを使ったソリューションビジネスを実現するためDX人材が必要。
 - ハードウェアに詳しい人材は多い一方、DXに取り掛かれる人材が不足。
- ⇒デジタルの仕組みそのものではなく、**デジタルを活用した課題解決に直結するスキルや組織変革を主導するマインドセットを学び、DX推進リーダーシップを育成できる講座が必要。**

プログラム概要（一部）

学習課題の
提供

学修成果の
活用

事業領域への
カスタマイズ

・実課題解決型学習（PBL）のカリキュラム

受講者の所属企業が抱える「実課題」をテーマに設定。
学修成果が業務改善や新規事業開発に直結。

・生成AI統合型のカリキュラム

受講者の所属業界を含む多様な領域にAIエージェントを組み込み、
業務自動化やツール連携など、最新の生成AI技術を実践的に習得。

【受講料】 495,000円

【受講時間数】 総履修時間102時間（修了要件60時間）



実績

- 正規受講（スマートエスイー-DXコース）：32名（修了30名）
- 修了生の約9割が、習得した知識・スキルを自社の業務改善や新規プロジェクトに直結。更に、修了生の約6割が学んだスキルを活かして希望する（または関連する）業務への配置転換を実現し、昇進や昇給に繋がった事例も多数。社員の意欲向上と定着にも寄与。

国立大学法人 九州工業大学（半導体）
半導体デバイス製造プロセス【前工程】セミナー

企業ニーズ（キオクシア株式会社等）

- 最先端半導体製造工場は高度に自動化が進み、ブラックボックス化。
 - 半導体技術も分野ごとに極細分化され、全体を俯瞰できる人材が不足。
 - 非技術者や生産系・ライン管理系技術職にも技術理解が不可欠。
- ⇒**設計から製造・評価までの半導体製造に関する一貫連続した知識と、設計・測定の実習により広範囲な経験を獲得できる講座が必要。**

プログラム概要（一部）

企業の新卒研修等としての活用

企業内の有識者
による解説・監修

・半導体の製造技術と一連の工程のイメージを把握できるカリキュラム

実際に受講生が手を動かしながら、回路の試作工程を体験。加工結果を光学顕微鏡で確認。測定・評価まで行い半導体技術の全体像を体系的に理解。

・基礎技術から最先端技術まで学習できるカリキュラム

国内の最先端企業で使われるnm（ナノメートル）級の微細加工技術につながる実践的な教育を実施。企業内の有識者（トップレベルのエンジニア）を客員教授として招聘し、遠隔型の解説・監修を実施。

【受講料】 199,800 円（税込）※実参加型 83,200 円（税込、50名時）※遠隔型

【受講時間数】 24時間30分（実参加型）、18時間（遠隔型）



手作業による半導体の試作



遠隔型の様子

実績

- 2018年以降、実参加型を84回実施。日本全国の様々な半導体関連企業等に所属する社会人921名が参加（遠隔版セミナー：2020年度以降20回、2436名が受講）。
- キオクシア株式会社（年300名程度）、Rapidus株式会社（年70名程度）の新卒者全員が遠隔型に参加。キオクシア株式会社（年28名）、ソニーグループ（年60名程度）の研究開発技術者が実参加型に参加。